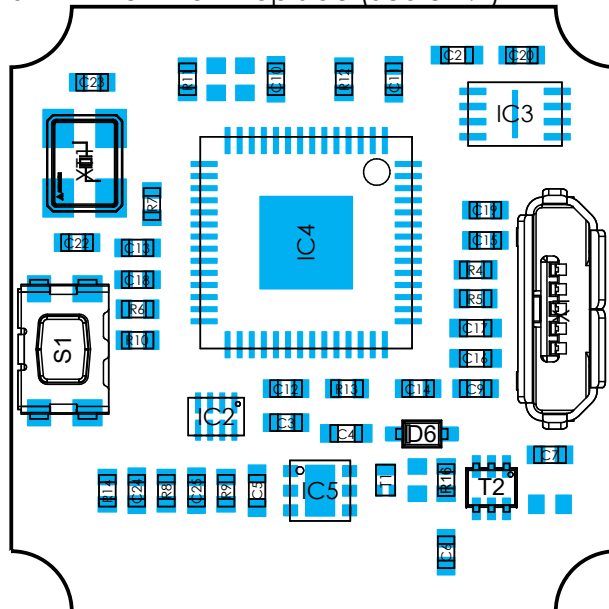


## **Osazovací předpis desky Lego Spike/EV3 Laser**

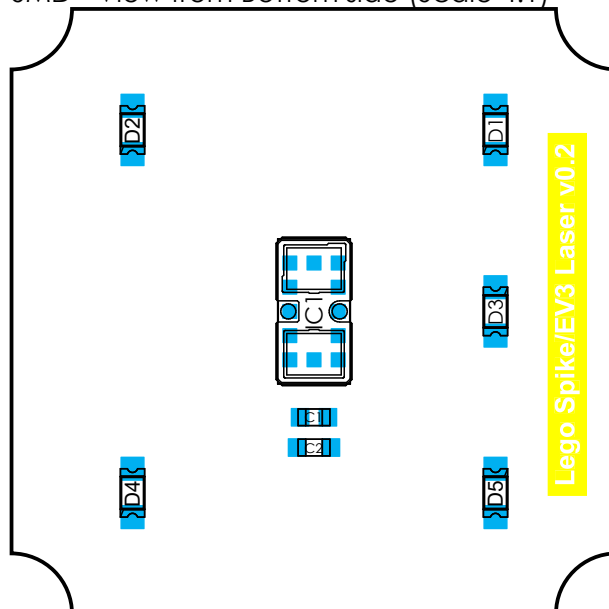
Předávání a kopírování dokumentu nebo sdělování jeho obsahu třetím osobám je zakázáno, bez souhlasu vlastníka dokumentu. Kopie předané třetí osobě musí být označeny textem „Pouze pro informaci“.

# OSAZOVACÍ PŘEDPIS

SMD - View from Top side (Scale 4:1)

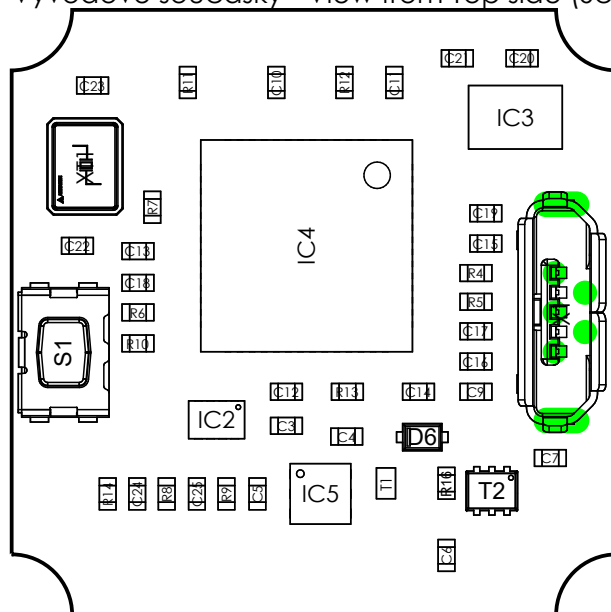


SMD - View from Bottom side (Scale 4:1)

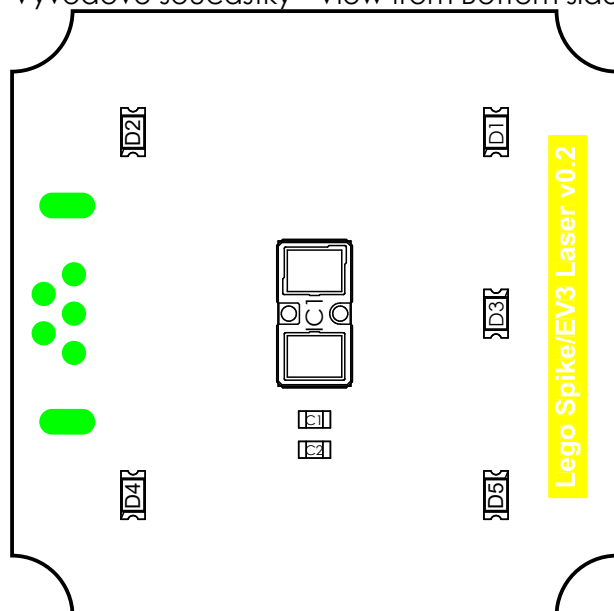


# OSAZOVACÍ PŘEDPIS

Vývodové součástky - View from Top side (Scale 4:1)

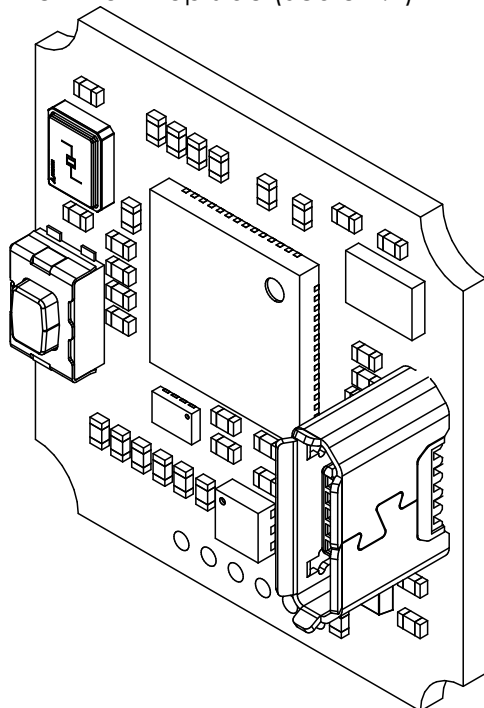


Vývodové součástky - View from Bottom side (Scale 4:1)

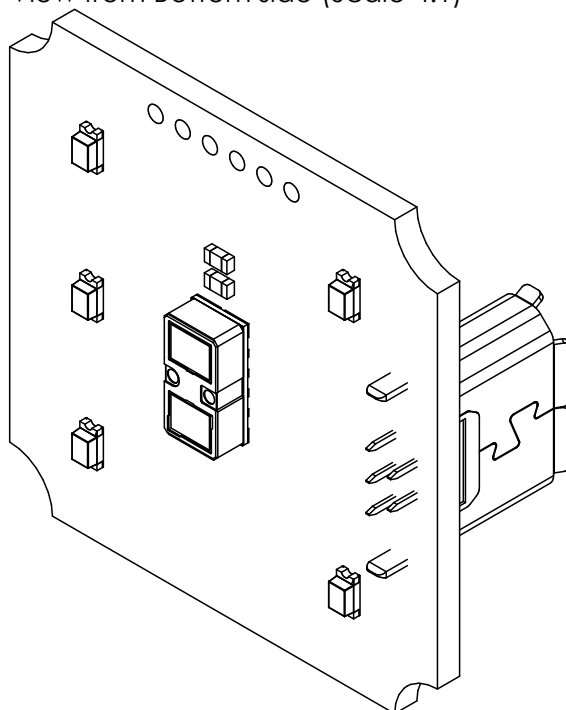


# OSAŽOVACÍ PŘEDPIS

View from Top side (Scale 4:1)



View from Bottom side (Scale 4:1)



# OSAŽOVACÍ PŘEDPIS

## Seznam součástek

Line #	Designator	Footprint	Value	name	Quantity
	IC1	VL53L1X	VL53L1CXV0FY/1	VL53L1CXV0FY/1	1
	IC4	QFN56	RP2040CT	RP2040CT	1
	IC2	X2SON-8_1.8x1.2	TXS0102DQMR	TXS0102DQMR	1
	IC5	WDFN6	NCP705MT33TCG	NCP705MT33TCG	1
	X1	USB3131-XX-0230-X	USB3131-30-0230-A	USB3131-30-0230-A	1
	IC3	USON-8_3x2	W25Q16JVUXIQ	W25Q16JVUXIQ	1
	XT1	ABM8	12 MHz	ABM8-12.000MHZ-B2-T	1
	S1	ButtonKMR2	KMR211G LFS	KMR211G LFS	1
	C24, C25	C0402	10pF / 50V	C0402C100D5GAC	2
	D1, D2, D3, D4, D5	LED0603	KPH-1608SGC	KPH-1608SGC	5
	C2, C16, C17, C21	C0402_big	4.7uF/10V	GRM155R61A475MEAAD	4
	C4, C5	C0402_big	4.7uF/10V	GRM155R61A475MEAAD	2
	C22, C23	C0402	27pF 50V	0402N270J500CT	2
	R6, R7, R16	R0402	1k 1%	CRCW04021K00FKED	3
	C1, C3, C6, C7, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C18, C19, C20	C0402	100nF 25V	0402B104K250CT	14
	R15	R0402	0R	CRCW04020000Z0ED	1
	R1, R2, R3, R10, R11, R12, R13, R14	R0402	2k2	CRCW04022K20FKED	8
	R4, R5, R8, R9	R0402	27R	CRCW040227R0FKED	4
	D6	SOD523	BAS716,115	BAS716,115	1
	T2	SOT-563-6	EMH53T2R	EMH53T2R	1
	T1	DFN1006-3	PBSS2515M	PBSS2515M,315	1